



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月10日

上場会社名 住友ベークライト株式会社

上場取引所 東大

コード番号 4203 URL <http://www.sumibe.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 林 茂

問合せ先責任者 (役職名) 経理企画本部副本部長

(氏名) 寺島 郁朗

TEL 03-5462-3452

四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	46,623	△2.2	2,543	△22.0	3,286	△15.7	1,954	△7.1
23年3月期第1四半期	47,683	32.0	3,260	—	3,896	—	2,103	—

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 3,492百万円 (223.5%) 23年3月期第1四半期 1,079百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	8.11	—
23年3月期第1四半期	8.73	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
24年3月期第1四半期	205,972	123,709	59.5
23年3月期	205,090	122,025	59.0

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 122,565百万円 23年3月期 120,933百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	7.50	—	7.50	15.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	7.50	—	7.50	15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	97,500	△0.4	5,500	△11.8	6,000	△14.4	3,200	△12.8	13.28
通期	200,000	4.7	13,500	20.7	14,300	14.3	8,000	55.2	33.21

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年3月期1Q	262,952,394 株	23年3月期	262,952,394 株
② 期末自己株式数	24年3月期1Q	22,025,627 株	23年3月期	22,024,150 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年3月期1Q	240,927,435 株	23年3月期1Q	240,949,286 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. サマリー情報(その他)に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
(四半期連結損益計算書)	
(第1四半期連結累計期間)	6
(四半期連結包括利益計算書)	
(第1四半期連結累計期間)	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4) セグメント情報等	8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	9
(6) 重要な後発事象	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期の世界経済は、欧米では高い失業率が続き財政・信用不安も解消されず、これまでの牽引役であった中国などの新興国においても金融引き締めなどから成長のスピードが緩み、景気の減速感が強まりました。

一方、国内経済は、東日本大震災により深刻な影響を受けましたが、足元ではサプライチェーンの立て直しが進み生産活動も緩やかに持ち直してきました。しかしながら、原子力発電所事故の終息は遠く、電力供給の制約や円高が続くなど依然として予断を許さない状況が続きました。

当社グループを取り巻く経営環境は、半導体については、スマートフォンやタブレット型端末などの携帯情報端末は好調でしたが、パソコンや薄型テレビなどの需要が低迷し市況は全体としてやや低調でした。自動車については、日系メーカーの生産は震災の影響で大きく減少しましたが、足元では漸く底を脱し回復基調になってきました。しかし中国や米国では購入促進政策の打ち切りやガソリン価格の高騰などにより販売の減速が顕著となるなど先行きに陰りがでてきました。また、国内の住宅着工件数も震災直後の減少から持ち直しの動きがでてきましたが厳しい状況が続いています。

当社グループは、このような経営環境の中、リーマンショック後の身の丈経営によりスリム化した企業体質を維持しながら、次の方針を掲げて新たな成長に向けて会社総合力を結集して取り組んできました。

①既存製品・既存事業での拡販、シェアアップ

②成長市場・分野での事業拡大

③新製品の早期戦力化

この結果、当第1四半期の経営成績につきましては、直前期の第4四半期と比較しますと半導体関連材料や高機能プラスチック製品の販売が伸長し、加えて固定費の抑制や赤字事業の構造改革に注力したことで増収増益となりました。しかしながら前年同期比では、円高により在外子会社の売上高が為替換算で大きく減少したことで連結売上高は10億60百万円減少の466億23百万円となり、利益につきましても、円高の進行や原料価格の上昇などの悪化要因が大きく、連結営業利益は前年同期比7億17百万円減少し25億43百万円、連結経常利益は6億10百万円減少し32億86百万円、連結四半期純利益は1億49百万円減少し19億54百万円となりました。

セグメント別販売状況(対前年同期比較)

①半導体関連材料

半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウェハーコート用液状樹脂、半導体実装用キャリアテープは、携帯情報端末などの新分野が好調でしたが、パソコンや薄型テレビなどの既存分野で低迷したことや、円高の影響により売上高は若干減少しました。

半導体基板材料「LαZ[®]」は、スマートフォンやタブレット型端末での採用が拡大し、売上高は順調に伸長しました。

なお、半導体基板材料「LαZ[®]」は、今後の大幅な需要拡大に対応すべく静岡事業所に加えて宇都宮事業所に第二の生産拠点を設置することを決定しました。

また、6月末において研究体制を再編し、宇都宮事業所は先端材料研究開発・新分野の開拓のための研究に特化し、既存製品の応用研究は顧客に近い拠点で行うべく、既に設置済のシンガポール、中国蘇州に加え、九州住友バークライト㈱と台湾住友培科股份有限公司にも研究所を設置することといたしました。

②回路製品

エポキシ樹脂銅張積層板・フェノール樹脂銅張積層板は、薄型テレビなどの民生機器向けが伸びず、売上高は減少しました。また、フレキシブル・プリント回路は、一部の不採算分野からの撤退などにより、売上高は減少しました。

③高機能プラスチック

フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂および成形品は、国内では自動車分野で震災による影響を大きく受けたものの、産業資材分野の鉄鋼関連・住宅設備関連は好調に推移し、欧州や北米では自動車分野を中心に伸長したことで、売上高は全体として増加しました。

なお、工業用フェノール樹脂の生産販売会社として中国江蘇省南通市に設立した「南通住友電木有限公司」に、中国市場の需要拡大への対応を図るべくフェノール樹脂成形材料工場も追加新設することを決定し、来年1月の稼働に向けて準備を進めています。

④クオリティオブライフ関連製品

医療機器製品は、胃瘻用ボタンが引き続き好調でしたが、震災の影響による前期末の駆け込み需要の反動が大きく、売上高は減少しました。

ビニル樹脂シートおよび複合シートは、工業用途が在庫調整などにより伸び悩みましたが、医薬品包装用途が好調なことから売上高は増加しました。

ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、メラミン樹脂化粧板・不燃板などのプレート・デコラ事業は、震災の影響が大きく、売上高は減少しました。

防水関連事業は、住宅リフォーム関連は好調で、ビルや工場などの一般建築物関連も堅調だったものの、主力の新築住宅関連が震災などの影響により振るわず、売上高は減少しました。

なお、防水関連事業は、充実した顧客対応により一層の事業拡大を図るために、7月より当社内の製造部門を住ベシート防水㈱に移管し、製造から販売・工事施工までを一貫して同社で行うことといたしました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(資産、負債および純資産の状況)

①資産の部

総資産は、前連結会計年度末に比べ8億82百万円増加し、2,059億72百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が57億6百万円減少した一方で、たな卸資産が21億89百万円、受取手形及び売掛金が14億84百万円増加したことおよび在外子会社の換算レートが前連結会計年度末に比べ円安に進行したため資産の円換算額が増加したことによるものであります。

②負債の部

負債合計は、前連結会計年度末に比べ8億1百万円減少し、822億63百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金が23億65百万円増加した一方で、コマーシャル・ペーパーを30億円減額したことによるものであります。

③純資産の部

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ16億84百万円増加し、1,237億9百万円となりました。

これは主に、四半期純利益を19億54百万円計上し、為替換算調整勘定が16億59百万円増加した一方で、配当金の支払18億6百万円があったことによるものであります。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成23年5月10日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。

2. サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	38,774	33,068
受取手形及び売掛金	40,560	42,044
商品及び製品	8,709	9,354
半製品	2,573	2,795
仕掛品	582	675
原材料及び貯蔵品	9,128	10,357
その他	6,342	7,762
貸倒引当金	△179	△103
流動資産合計	106,492	105,954
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	30,245	30,280
機械装置及び運搬具（純額）	24,172	24,183
その他（純額）	18,773	19,870
有形固定資産合計	73,191	74,335
無形固定資産		
のれん	5,255	5,271
その他	1,131	1,168
無形固定資産合計	6,387	6,439
投資その他の資産	19,019	19,242
固定資産合計	98,597	100,017
資産合計	205,090	205,972

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	28,681	31,046
短期借入金	5,157	5,245
コマーシャル・ペーパー	11,000	8,000
未払法人税等	1,199	1,398
賞与引当金	2,670	1,415
災害損失引当金	1,034	960
その他	10,832	12,113
流動負債合計	60,574	60,180
固定負債		
長期借入金	11,501	11,500
退職給付引当金	6,702	6,275
事業再建費用引当金	363	428
その他の引当金	370	362
負ののれん	790	585
その他	2,761	2,931
固定負債合計	22,490	22,082
負債合計	83,064	82,263
純資産の部		
株主資本		
資本金	37,143	37,143
資本剰余金	35,358	35,358
利益剰余金	79,140	79,287
自己株式	△11,925	△11,926
株主資本合計	139,716	139,862
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,287	1,123
為替換算調整勘定	△18,570	△16,911
在外子会社の退職給付債務調整額	△1,499	△1,508
その他の包括利益累計額合計	△18,782	△17,296
少数株主持分	1,092	1,143
純資産合計	122,025	123,709
負債純資産合計	205,090	205,972

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	47,683	46,623
売上原価	33,723	33,195
売上総利益	13,959	13,427
販売費及び一般管理費	10,698	10,883
営業利益	3,260	2,543
営業外収益		
受取利息	23	35
受取配当金	297	311
負ののれん償却額	205	205
持分法による投資利益	52	32
為替差益	147	236
雑収入	119	122
営業外収益合計	845	943
営業外費用		
支払利息	84	79
雑損失	125	121
営業外費用合計	209	200
経常利益	3,896	3,286
特別利益		
固定資産売却益	0	3
特別利益合計	0	3
特別損失		
固定資産除売却損	180	76
投資有価証券評価損	205	0
事業再建関連費用	43	71
減損損失	122	122
解決金等	87	331
環境対策引当金繰入額	73	—
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	79	—
その他	13	1
特別損失合計	805	604
税金等調整前四半期純利益	3,091	2,685
法人税、住民税及び事業税	485	541
法人税等調整額	455	155
法人税等合計	941	696
少数株主損益調整前四半期純利益	2,150	1,988
少数株主利益	46	34
四半期純利益	2,103	1,954

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	2,150	1,988
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,248	△163
為替換算調整勘定	101	1,671
在外子会社の退職給付債務調整額	70	△9
持分法適用会社に対する持分相当額	5	5
その他の包括利益合計	△1,070	1,503
四半期包括利益	1,079	3,492
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,007	3,440
少数株主に係る四半期包括利益	71	52

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

I 前第1四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ ィオブラ イフ関連 製品	計				
売上高									
外部顧客への売上高	13,224	4,976	14,961	14,354	47,517	165	47,683	—	47,683
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	103	85	188	—	188	△188	—
計	13,224	4,976	15,065	14,440	47,706	165	47,872	△188	47,683
セグメント利益又は 損失(△)	2,060	△429	1,692	764	4,087	6	4,093	△833	3,260

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益又は損失(△)」の調整額△833百万円には、セグメント間取引消去14百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△847百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第1四半期連結累計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連 結損益計 算書計上 額 (注) 3
	半導体 関連材料	回路製品	高機能 プラス チック	クオリテ ィオブラ イフ関連 製品	計				
売上高									
外部顧客への売上高	13,257	4,021	15,131	14,049	46,459	164	46,623	—	46,623
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	125	25	151	—	151	△151	—
計	13,257	4,021	15,256	14,074	46,610	164	46,774	△151	46,623
セグメント利益又は 損失(△)	1,498	△254	1,429	685	3,359	△17	3,341	△798	2,543

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、試験研究の受託、土地の賃貸等を含んでおります。

2 「セグメント利益又は損失(△)」の調整額△798百万円には、セグメント間取引消去3百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△801百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究費用等であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

各報告セグメントの主要な製品および役務の内容は以下のとおりであります。

報告セグメント	主要な製品および役務の内容
半導体関連材料	半導体封止用エポキシ樹脂成形材料、感光性ウエハーコート用液状樹脂、半導体用液状樹脂、半導体実装用キャリアテープ、半導体チップ接着用テープ、半導体基板材料
回路製品	フレキシブル・プリント回路、フェノール樹脂銅張積層板、エポキシ樹脂銅張積層板
高機能プラスチック	フェノール樹脂成形材料、工業用フェノール樹脂、精密成形品、合成樹脂接着剤
クオリティオブライフ関連製品	医療機器製品、メラミン樹脂化粧板・不燃板、ビニル樹脂シートおよび複合シート、鮮度保持フィルム、ポリカーボネート樹脂板、塩化ビニル樹脂板、防水工事の設計ならびに施工請負、バイオ製品

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(6) 重要な後発事象

該当事項はありません。